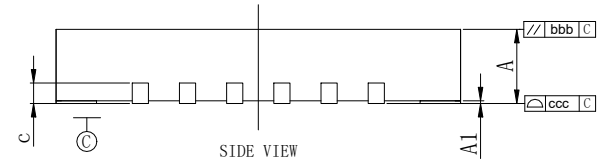


| | SYMBOL | MILLIMETER | | | |
|---|--------|------------|---------|------|------|
| | | MIN | NOM | MAX | |
| TOTAL THICKNESS | A | 0.50 | 0.55 | 0.60 | |
| STAND OFF | A1 | 0 | 0.02 | 0.05 | |
| LEAD WIDTH | b | 0.12 | 0.17 | 0.22 | |
| LEAD END WIDTH | b1 | 0.12REF | | | |
| L/F THICKNESS | c | 0.152REF | | | |
| BODY SIZE | X | D | 2.90 | 3.00 | 3.10 |
| | Y | E | 2.90 | 3.00 | 3.10 |
| LEAD PITCH | e | 0.35BSC | | | |
| EP SIZE | X | D2 | 1.60 | 1.70 | 1.80 |
| | Y | E2 | 1.60 | 1.70 | 1.80 |
| ACCUMULATIVE PITCH | X | Nd | 1.75BSC | | |
| | Y | Ne | 1.75BSC | | |
| LEAD LENGTH | L | 0.25 | 0.30 | 0.35 | |
| SPACING BETWEEN LEAD EDGE TO E-PAD EDGE | K | 0.35REF | | | |
| PIN 1# ID | h | 0.20 | 0.25 | 0.30 | |
| PACKAGE EDGE TOLERANCE | aaa | 0.10 | | | |
| MOLD FLATNESS | bbb | 0.10 | | | |
| COPLANARITY | ccc | 0.08 | | | |
| LEAD OFFSET | ddd | 0.10 | | | |
| EXPOSED PAD OFFSET | eee | 0.10 | | | |



***特殊要求: 无

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----------|--|-----|--|-------|--|---|--|---|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| 参考图号 | | 客户要求 | | 拟 制 | | 复 审 | | 更改标记 | | 更改内容 | | 签 名 | | 日 期 | | | |
| 幅 面: A4 | | 比 例: 1:1 | | 审 核 | | 会 签 | | 华天科技(西安)有限公司 Hua Tian Technology (Xi'an) Co., Ltd. | | 图号: HTDX02403030006 QFN24L (0303X0.55-0.35) (A) 产品外形图 | | 单 位 | | 版 次 | | 密 级 | |
| | | | | 制 图 | | 标 准 化 | | | | | | mm | | 0版 | | 秘密 | |
| | | | | 批 准 | | 批 准 | | 第 1 张 | | 共 1 张 | | | | | | | |

